

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和6年5月21日(2024.5.21)

【国際公開番号】WO2023/238951

【出願番号】特願2024-508602(P2024-508602)

【国際特許分類】

C 0 8 L 6 3 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

C 0 8 L 6 3 / 0 0

Z

10

【手続補正書】

【提出日】令和6年2月9日(2024.2.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

エポキシ樹脂と、

活性エステル化合物及びフェノール硬化剤を含む硬化剤と、

チタン酸カルシウム粒子を含む無機充填材と、

を含み、

前記活性エステル化合物及び前記フェノール硬化剤の合計量に占める活性エステル化合物の質量割合は、40質量%～70質量%である成形用樹脂組成物。

20

【請求項2】

前記チタン酸カルシウム粒子の含有率は、無機充填材全体に対して30体積%～60体積%である請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項3】

応力緩和剤をさらに含む、請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項4】

前記応力緩和剤は、インデン-スチレン-クマロン共重合体、トリアルキルホスフィンオキサイド及びトリアリールホスフィンオキサイドの少なくともいずれか1つを含む、請求項3に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項5】

前記フェノール硬化剤は、アラルキル型フェノール樹脂及びメラミン変性フェノール樹脂を含む請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項6】

無機充填材全体の含有率は、成形用樹脂組成物全体に対して55体積%を超えている請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

30

40

【請求項7】

前記フェノール硬化剤は、メラミン変性フェノール樹脂を含み、メラミン変性フェノール樹脂の含有率は、エポキシ樹脂全量に対し、1質量%～8質量%である請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項8】

前記エポキシ樹脂は、o-クレゾールノボラック型エポキシ樹脂及びビフェニル型エポキシ樹脂又はビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂及びビフェニル型エポキシ樹脂を含む請求項1に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項9】

50

高周波デバイスに用いられる、請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれか 1 項に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項 10】

高周波デバイスにおける電子部品の封止に用いられる、請求項 9 に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項 11】

アンテナ・イン・パッケージに用いられる、請求項 9 に記載の成形用樹脂組成物。

【請求項 12】

支持部材と、

前記支持部材上に配置された電子部品と、

10

前記電子部品を封止している請求項 1 ~ 請求項 8 のいずれか 1 項に記載の成形用樹脂組成物の硬化物と、

を備える電子部品装置。

【請求項 13】

前記電子部品がアンテナを含む請求項 12 に記載の電子部品装置。

20

30

40

50